

## USPTO、半導体デバイス関連発明の審査を迅速に行う試行プログラムを発表

2023 年 12 月 5 日  
JETRO NY 知的財産部  
蛭田、福岡

USPTO は、半導体デバイスの製造方法または製造装置に関する特許出願の審査を迅速に行う試行プログラム (Semiconductor Technology Pilot Program) の開始を 11 月 30 日付の官報<sup>1</sup>で発表した。同プログラムへの申請受付は 12 月 1 日から開始されている。

このプログラムは、2022 年 8 月に成立した「Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act (CHIPS 法)<sup>2</sup>」の目的を支援するための取組とされている。同法では、中国との競争を念頭に、米国内での半導体製品の生産の奨励や先端技術分野の研究開発の強化に関する施策が規定されており、関連技術の特許出願の審査を迅速化することで半導体技術のイノベーションの促進を図りたいと USPTO は説明している。

試行プログラムの概要は以下のとおり<sup>3</sup>。

- 対象となる出願は、半導体デバイスの製造方法または製造装置のクレームを 1 つ以上含む特許出願（非仮出願）の他、継続出願、分割出願および国際特許出願（PCT 出願）に基づき国内移行された特許出願。
- 出願または国内移行には、電子出願システム (Patent Center) を利用し、明細書等の書類を DOCX 形式とすることが求められる。試行プログラムの申請書の提出期間は、出願または国内移行から 30 日以内とする。
- USPTO は、試行プログラムへの申請を、2024 年 12 月 2 日またはプログラムの対象案件が 1,000 件に達するいずれか早い日まで受理する。

試行プログラムの開始について、米国商務省の Raimondo 長官は「CHIPS 法は、米国のイノベーションを促進し、安全保障を保護し、国際的な経済競争力を維持するまたとない機会である。今回のプログラムによって、米国内の半導体製造への投資を促進するために重要な知財の保護が優先される環境が保証される」と発言し、USPTO の Vidal 長官は「今回のプログラムによって、重要なイノベーションの市場投入が早まり、米国のサプライチェーンが強化される。このプログラムの目標は、半導体チップ供給の海外への依存を減らしながら、より多くの最先端技術をより早く消費者の手に届けることである」と発言している。

(以上)

<sup>1</sup> <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-12-01/pdf/2023-26340.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/50bd3e1715a7131c.html>

<sup>3</sup> 詳細は本プログラムに関する USPTO ウェブサイトを参照。